

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 19 日(19.04.2012)

PCT

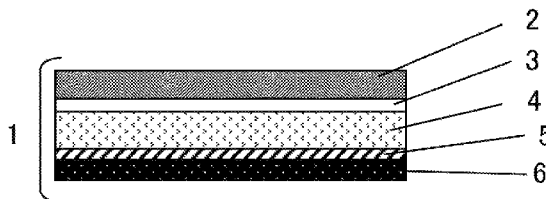
(10) 国際公開番号
WO 2012/049873 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 73/02 (2006.01) B65D 85/86 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/059533
- (22) 国際出願日: 2011 年 4 月 18 日(18.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-230907 2010 年 10 月 13 日(13.10.2010) JP
特願 2010-237436 2010 年 10 月 22 日(22.10.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐々木 彰 (SASAKI Akira) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 徳永 久次 (TOKUNAGA Hisatsugu) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 藤村 徹夫 (FUJIMURA Tetsuo) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外 (SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: COVER FILM

(54) 発明の名称: カバーフィルム

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is a cover film which is used in combination with a carrier tape and comprises at least a base layer (A), an intermediate layer (B), a releasing layer (C) and a heat seal layer (D) that is capable of being heat sealed to the carrier tape. The intermediate layer (B) contains, as a main component, a linear low density polyethylene that is polymerized using a metallocene catalyst and has a tensile modulus of 200 MPa or less. The releasing layer (C) contains a conductive material and also contains, as a main component, a hydrogenated resin of an aromatic vinyl-conjugated diene copolymer having an aromatic vinyl group content of 15-35% by mass. This cover film is small in variation in peel strength when the cover film is released, and is thus capable of suppressing troubles during the releasing in a mounting process.

(57) 要約: 基材層 (A)、中間層 (B)、剥離層 (C)、及びキャリアテープにヒートシール可能なヒートシール層 (D) を少なくとも含んでなり、中間層 (B) が、メタロセン触媒を用いて重合した引張弾性率が 200 MPa 以下の直鎖低密度ポリエチレンを主成分として含み、剥離層 (C) が、導電材を含有する共に、芳香族ビニル基の含有量が 15~35 質量%である芳香族ビニル共役ジエン共重合体の水素添加樹脂を主成分として含んでなる、キャリアテープとの組み合わせで用いるカバーフィルムが開示される。このようなカバーフィルムは剥離する際の剥離強度のバラツキが小さく、剥離の際の実装工程でのトラブルが抑制できる。



WO 2012/049873 A1